# 半导体表面与MIS结构

# 复旦大学 微电子学系

13307130163

李琛

June 18, 2015

# **Contents**

1	半导	<sup>2</sup> 导体表面态															3										
	1.1	理想表	面			•					•		•				 	•				 					3
	1.2	实际表	面										•			•				•	•	 	•				3
2	表面	表面电场效应																3									
	2.1	空间电	l荷层										•			•		•				 					3
	2.2	表面静	电特性															•				 					5
	2.3	表面层	的五种基	基本	状系	泛												•				 					5
		2.3.1	积累 .															•				 					5
		2.3.2	平带 .			•																 				. <b>.</b>	6
		2.3.3	耗尽 .			•										•						 		•			6
		2.3.4	弱反型			•										•						 		•			6
		2.3.5	强反型														 					 					6

3	MIS	MIS结构C-V特性																7								
	3.1	理想MIS结构C-V特性															7									
		3.1.1	积累												•			•			 			•	•	7
		3.1.2	平带																		 				•	7
		3.1.3	耗尽					•																	•	7
		3.1.4	强反型	Ũ.				•																	•	8
	3.2	2 实际MIS结构C-V特性																8								
4	Si –	Sion系	统性质																							8

## 1 半导体表面态

### 1.1 理想表面

理想表面的薛定谔方程有两组解,一组对应无限周期场,一组对应表面态

$$\varphi_1(x) = Aexp\left\{\frac{[2m_0(v_0 - E)]^{(1/2)}}{\hbar}x\right\}(x \le 0)$$

波函数在表面指数衰减,说明电子主要分布在表面附近 每个表面原子对应禁带中一个表面能级,这些能级组成表面能带 **悬挂键** 在表面的最外层的硅原子有一个未配对的电子,与之对应的就是表面态。

### 1.2 实际表面

- 清洁表面 超高真空下解理,有重构现象.
- **真实表面** 天然氧化层,界面态10<sup>10</sup> 10<sup>12</sup> cm<sup>-2</sup> 空态下施主型俘获电子后呈电中性,受主型俘获电子后呈负电荷态
- 界面
  - 不同导电类型 Si pn结(同质结) M O S MOSFET
  - 不同半导体 异质结 晶粒间界 多晶结构
  - 金属-半导体 肖特基接触、欧姆接触

## 2 表面电场效应

### 2.1 空间电荷层

MIS结构实际上就是电容, $Q_m = -Q_s$ ,但半导体中自由载流子浓度低得多,对应 $Q_s$ 的电荷量需要分布在一定厚度的表面层内,这个带电的表面层即为空间电荷层 **表面势** $V_s$  空间电荷层两端的电势差,表面比内部高为正 电势沿电力线方向减小,而能带为电势乘以-q

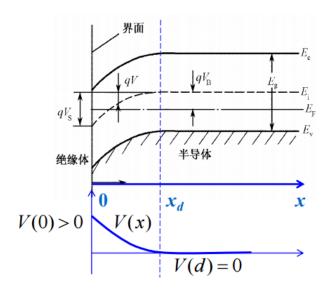


Figure 1: 表面势与能带的关系

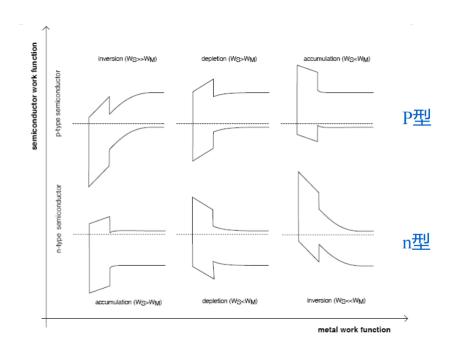


Figure 2: 可能的热平衡MIS结构的能带图

利用泊松方程与玻尔兹曼统计,可以解出电容 一维情况下的P型半导体

$$\begin{cases} \frac{d^2V(x)}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s} \\ n_p = n_{p0}exp(qV/k_BT), p_p = p_{p0}exp(qV/k_BT) \end{cases}$$
解得 $E(x) = \pm \frac{2kT}{qL_D}F(\frac{qV(x)}{kT}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}})$ 

$$F\left(\frac{qV(x)}{kT}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right) = \left\{ \left[ exp\left(-\frac{qV}{kT}\right) + \frac{qV}{kT} - 1 \right] + \frac{n_{n0}}{p_{p0}} \left[ exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - \frac{qV}{kT} - 1 \right] \right\}^{1/2}$$
德拜长度 $L_D = \left(\frac{2\varepsilon_s k_B T}{q^2 p_{p0}}\right)^{1/2}$ 

$$C_s = \left| \frac{dQ_s}{dV_s} \right| = \frac{\varepsilon_s}{L_D} \frac{\left[ -exp\left(-\frac{qV_s}{kT}\right) + 1 \right] + \frac{n_{n0}}{p_{p0}} \left[ exp\left(\frac{qV_s}{kT}\right) - 1 \right]}{F(\frac{qV(x)}{kT}, \frac{n_{p0}}{n_{p0}})}$$

### 2.2 表面静电特性

$$E_s = \pm \frac{2kT}{qL_D} F(\frac{qV_s}{kT}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}})$$

$$Q_s = -\varepsilon_s E_s = \mp \frac{2\varepsilon_s kT}{qL_D} F\left(\frac{qV(x)}{kT}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right)$$

### 2.3 表面层的五种基本状态

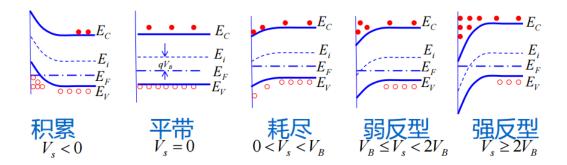


Figure 3: 表面层的五种基本状态

$$Q_s \propto E_s \propto F\left(\frac{qV(x)}{kT}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right) = \left\{ \left[exp\left(-\frac{qV}{kT}\right) + \frac{qV}{kT} - 1\right] + \frac{n_{n0}}{p_{p0}} \left[exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - \frac{qV}{kT} - 1\right] \right\}^{1/2}$$

#### 2.3.1 积累

$$Q \propto exp\left(-\frac{qV_s}{2kT}\right)$$

#### 2.3.2 平带

$$Q = 0, C_{FBS} = \lim_{V_s \to 0} \frac{dQ_s}{dV_s} = \frac{\sqrt{2}\varepsilon_s}{L_D} \left( 1 + \frac{n_{p0}}{p_{p0}} \right)^{1/2} \approx \frac{\sqrt{2}\varepsilon_s}{L_D}$$

#### 2.3.3 耗尽

也可用耗尽层近似求解

$$F\left(\frac{qV(x)}{kT}, \frac{n_{p0}}{p_{p0}}\right) = \left(\frac{qV_s}{kT}\right)^{1/2} \Rightarrow Q_s = -\frac{2\varepsilon_s kT}{qL_D} \left(\frac{qV_s}{kT}\right)^{1/2}$$

#### 2.3.4 弱反型

$$Q_s = -\frac{2\varepsilon_s kT}{qL_D} \left(\frac{qV_s}{kT}\right)^{1/2}$$

#### 2.3.5 强反型

$$Q_s \propto exp\left(\frac{qV_s}{2kT}\right)$$

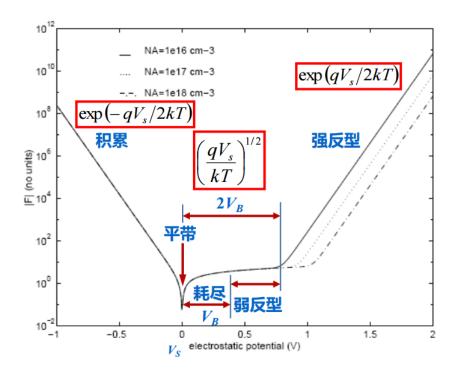


Figure 4: F函数与电势的关系

## 3 MIS结构C-V特性

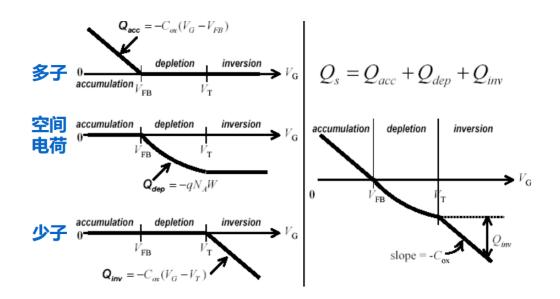


Figure 5: 电荷随VG的变化

### 3.1 理想MIS结构C-V特性

理想条件 假设在绝缘层中和绝缘层与半导体的界面不存在电荷,也不存在界面态,并且栅电压V=0时半导体中不存在电场,能带是平直的。

$$rac{1}{C}=rac{1}{C_{ox}}+rac{1}{C_{S}}$$
,  $C_{ox}=rac{arepsilon_{ox}}{d_{ox}}$ 为氧化层电荷,是常数

#### 3.1.1 积累

$$C_s = \frac{\varepsilon_s}{L_D} exp\left(-\frac{qV_s}{2k_BT}\right) >> C_{ox} \Rightarrow C = C_{ox}$$

#### 3.1.2 平带

$$C_{FBS} pprox rac{\sqrt{2}arepsilon_s}{L_D} \Rightarrow C = rac{C_{ox}}{1 + rac{arepsilon_{ox}}{d_{ox}} \left(rac{k_B T}{q^2 N_A arepsilon_s}
ight)^{1/2}}$$

### 3.1.3 耗尽

$$C_s pprox rac{arepsilon_s}{L_D} \sqrt{rac{k_B T}{q V_s}} = \sqrt{rac{q N_A arepsilon_s}{2 V_s}} \Rightarrow C pprox rac{C_{ox}}{1 + \sqrt{rac{2 C_{ox}^2}{q arepsilon_s N_A}} (V_G - V_{FB})}$$

### 3.1.4 强反型

$$C_s \approx rac{arepsilon_s}{L_D} \sqrt{rac{n_{p0}}{p_{p0}}} exp\left(rac{qV_s}{2k_BT}
ight) >> C_{ox} \Rightarrow C = C_{ox}$$

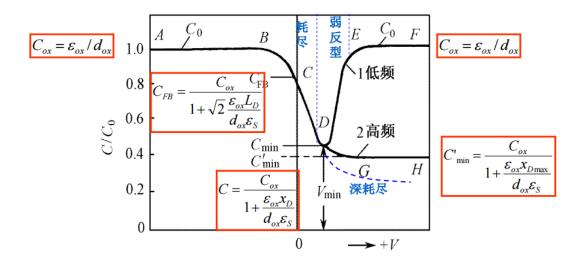


Figure 6: 理想MIS C-V特性

### 3.2 实际MIS结构C-V特性

- 功函数的影响 将图像向右平移V<sub>ms</sub>
- 平带电压的影响 将图像向右平移V<sub>FB</sub>
- **界面态的影响** 绝缘层和半导体界面处的电子能级称为界面态。能级处于禁带之中, 是一个连续分布的界面态。

 $N_{ss}(E)$ 为界面态密度的分布函数。

界面态电容与表面电容是并联的

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{os}} + \frac{1}{C_{S} + C_{Nss}}, C_{Nss} = q^2 N_{ss}(E)$$

# 4 Si-Sio<sub>2</sub>系统性质

● 界面陷阱电荷(快界面态) *Qit* 

氧化层中可动电荷 Q<sub>n</sub>

● 氧化层中固定电荷 Qf

氧化层中陷阱电荷 Q<sub>ot</sub>